

# Minimal Sputtering Target

# ミニマルスパッタリングターゲット

当社ではミニマルスパッタリングターゲットなどの小型ターゲットを作製。  
特殊形状、特殊組成、開発・量産向け、多品種小ロット等用途に合わせたターゲットの  
作製を承ります。

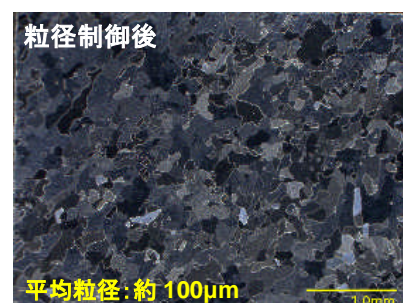
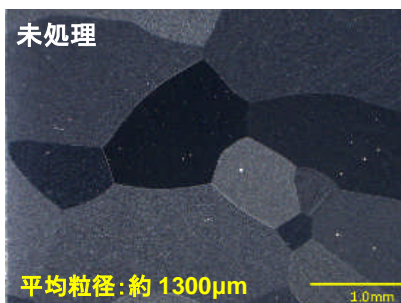
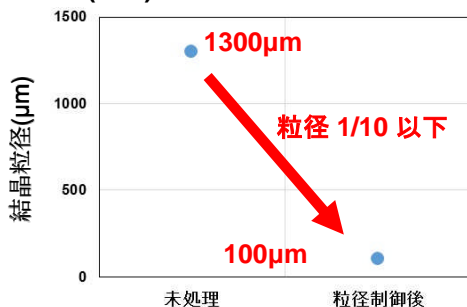
## ＜当社ターゲットの特長＞

成膜プロセス(放電状態等)の安定や膜質向上のため、以下のような特殊な処理を行います。

### 特長Ⅰ 「Grain Control (結晶粒径制御)」

- ・ 鑄造時の大きい結晶粒を特殊な加工法により微細化

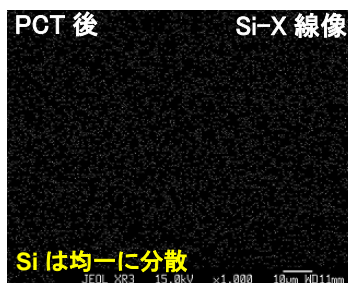
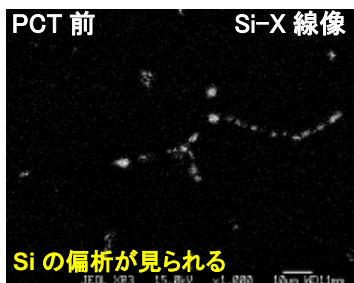
＜例：純 Al(5N5)ターゲットの結晶粒微細化＞



### 特長Ⅱ 「PCT (析出制御処理)」

- ・ 鍛造後の偏析した添加元素を均一に分散させる処理

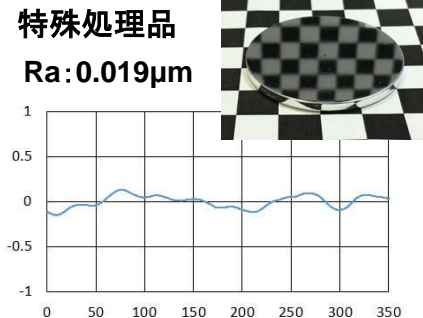
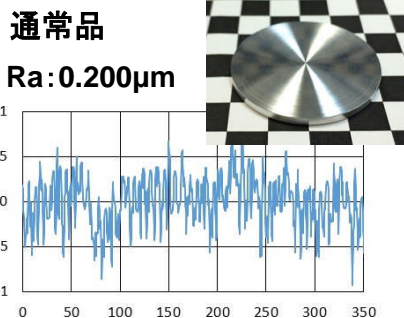
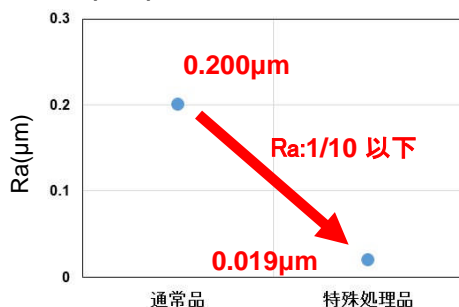
＜例：Al-1(wt%)Si 合金ターゲットの偏析改善＞



### 特長Ⅲ 「特殊表面処理」

- ・ 特殊な処理によりターゲット表面状態を改善

＜例：純 Al(5N5)ターゲットの表面粗度改善＞



## 株式会社 ワイドテクノ

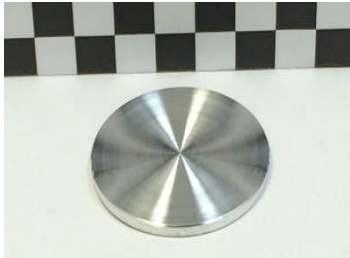


宮城県加美郡加美町字雁原 501 (雁原工業団地内)  
〒981-4263 <http://wide-techno.co.jp/>  
TEL: 0229-63-6909 FAX: 0229-63-7180  
E-mail: [info@wide-techno.co.jp](mailto:info@wide-techno.co.jp)  
担当: 遠藤

# 製品紹介

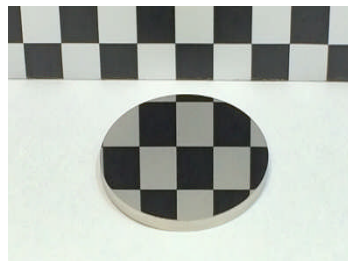
- ・弊社ではお客様のニーズに合ったターゲットを作製致します

<加工事例>



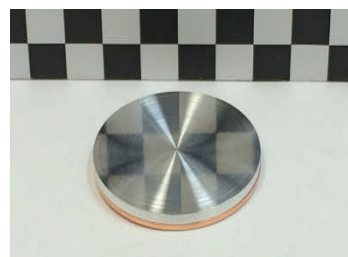
通常品  
(例: Ti)

特殊表面処理  
(例: Ti)



多彩な形状に対応  
(円形以外に矩形も加工可能)

ボンディング対応  
可能  
(例: Al/Cu)



## 高純度スパッタリングターゲット

- ・半導体などに使われる高純度ターゲットを販売しております。

Material	Name	Purity
Al	Aluminum	5N, 5N5
Au	Gold	4N
Cr	Chromium	4N
Cu	Copper	4N5, 5N, 6N
Ni	Nickel	4N
Pt	Platinum	3N5, 4N
Ti	Titanium	4N5

\*上記以外の材料も御用意できますので  
お気軽に御相談ください。

当社では小型スパッタリングターゲットを主に製作しております。

- ① 小ロットから量産品、実験開発用特殊材料の受託加工などに対応します。
- ② 自社工場での加工によりスピーディーな納期対応、細かな要望事項にもお答えいたします。
- ③ 材料調達から製造プロセス、納入迄、品質の管理を徹底しております。
- ④ 多品種小ロットにも対応いたします。研究開発や試作などお気軽にお問い合わせください。

## 株式会社 ワイドテクノ



WIDE TECHNO

宮城県加美郡加美町字雁原 501 (雁原工業団地内)

〒981-4263

<http://wide-techno.co.jp/>

TEL: 0229-63-6909 FAX: 0229-63-7180

E-mail: [info@wide-techno.co.jp](mailto:info@wide-techno.co.jp)

担当: 遠藤